2015 年 6 月 2 日

各　位

タツタ電線株式会社

パナソニック株式会社殿より ALIVH 基板に関する特許を取得

このたびタツタ電線株式会社（本社：大阪府東大阪市岩田町２－３－１、社長：木村政信）とパナソニック株式会社（本社：大阪府門真市大字門真 1006 番地、社長：津賀一宏）とは、パナソニック株式会社が所有する導電性ペーストを使用したプリント配線板の製造特許（ALIVH 基板に関する特許）の一部に関して下記内容の譲渡契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。

記

１）契約の主な内容

弊社とパナソニック株式会社殿とは､同社保有の ALIVH 基板の材料に特徴を有する特許のうち日本特許 6 件、米国特許 2 件、欧州、中国、台湾特許　各 1 件の計 11 件の特許権の取得について合意いたしました。上記特許には一般的なプリント配線板（以下、「PCB」）やフレキシブルプリント配線板（以下、「FPC」）に関連する構成、また製造方法が含まれております。

２）特許についての主な内容

ALIVH 基板とはプリプレグの任意の位置にレーザ穴加工を行い、導電性ペーストを充填した後の熱プレス過程で絶縁層の成型と同時に層間の電気的な接続を形成することが出来る多層基板です。ALIVH 基板は、ビルドアップ基板と比較しプロセスが単純でめっき接続を必要としないことから、化学物質の使用や廃液処理などが必要のない環境に配慮した基板です。PCB 向けはもちろんのこと FPC 向けにも展開した特許となります。

３）今後の見通しについて

今回の合意により、弊社独自で開発している金属溶融型導電性ペースト（メタライズペースト）と ALIVH 技術との融合により、従来よりも信頼性の高い多層基板を短期間で製造することが可能になります。今後ますます需要が見込まれ、かつ環境対応が求められるアジア地域をはじめとし全世界のユーザに対して金属溶融型導電性ペースト（メタライズペースト）販売を加速することが出来ます。また、部品内蔵基板等のパーケージ分野でも同技術の応用展開を見込むことが出来るため事業の拡大を積極的に

推進してまいります。

本件に関する問い合わせ先：東大阪市岩田町２－３－１
タツタ電線株式会社　総務部　広報担当
山本　英輔
☎０６－６７２１－３３３１
京都府木津川市州見台６－５－１
タツタ電線株式会社
システム・エレクトロニクス事業本部
機能性材料事業部　坂口　充弘
☎０７７４－６６－５５５１

以上